

吉安满坤科技股份有限公司

2025年6月6日投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	红思客资产杨岌中金财富王翩 金航国际时文里 北斗星投资吴文贵 国海证券孙宏声宁波银行林木胜 诺泉投资刘振宇华创证券严卫松 幸福階乘基金张东晓
时间	2025年6月6日（星期五）10:30-12:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：耿久艳女士 证券事务代表：莫琳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司整体情况</p> <p>董事会秘书简要介绍了公司发展历程、主要产品、应用领域、核心竞争力及行业未来的趋势等。</p> <p>二、问答</p> <p>1、公司高多层产品占比是多少，重点领域汽车电子产品占比是多少？</p> <p>答：2025年第一季度公司高多层产品占比约60%，重点领域汽车电子产品占比约30%，谢谢。</p> <p>2、公司是否有回购计划？</p> <p>答：公司管理层对公司未来发展前景一直很有信心，截至目前公司暂无回购计划，公司后续如有相关的回购计划，将严</p>

格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

3、公司泰国投资金额是多少，目前投资的进度是怎样的？

答：公司使用自有资金和自筹资金不超过 7,000 万美元在泰国投资新建生产基地，公司已顺利完成泰国公司的设立登记、国内备案登记、土地协议签署、增资等事宜，并取得泰国投资促进委员会（BOI）颁发的《投资优惠证书》，目前正在逐步推进泰国工厂的基建筹备工作。

4、公司的毛利率怎样，哪个领域毛利率比较高？

答：2024 年度，公司 PCB 产品毛利率为 10.44%，目前公司汽车电子领域的产品毛利率比较高。

5、公司未来研发投入的重点是什么？

答：公司将稳步提升汽车电子 PCB 产能，并持续加大对新能源车核心三电（电池、电机、电控）系统、自动驾驶系统、安全系统等 PCB 产品的研发投入。同时，为了满足客户个性化、多样化和高阶化的产品结构需求，公司引进了多位行业高阶 PCB 和 HDI 的专业人才，在巩固刚性板产品优势的基础上，组织开展对高阶 PCB（Notebook、服务器产品）和高阶高密度互联板（二阶 LED 显示产品、三阶 HDI 车载自动驾驶/域控制等产品）的研发拓展工作。其次，进一步深入加强对高频/高速板、超厚铜板、陶瓷基板、埋铜块等特殊产品的工艺研发，不断丰富完善公司产品结构，提升公司整体竞争力。

6、请问在服务器、三阶 HDI、高端显卡产品方面研发进度如何？

答：公司目前 16 层服务器电源产品已经完成工艺技术研发和样品制作，下一步进入 PVT 阶段；汽车领域三阶 HDI 智能驾驶域控产品已完成 PVT 样板制作，目前客户端测试中；高端显卡产品（14 层 3 压二阶 HDI）进入 PVT 阶段。

7、公司目前订单如何？

答：目前公司在手订单充足，谢谢。

8、请问董秘怎么看待公司客户集中度比较高的情况？

答：2024年，公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为35.92%，单一客户占比未超过10%，客户集中度与同行业其他上市公司相比，该比例处于行业正常水平。

9、请问汽车电子客户的回款情况如何？

答：在客户开发阶段，公司会按照内部管理流程向保险公司提交该客户信用额度申请，待保险公司进行征信评估并下发批复额度和信用期限后，公司才在批复额度和信用期限内与客户开展业务合作；同时在日常业务合作中，密切关注客户的出货和收款情况，及时跟催货款到位。近几年来，公司汽车电子客户回款良好，未曾出现坏账或者信用保险理赔情况。

10、请问公司主要采用“以销定产”的生产模式，随着销量的增加，库存压力是否也会增加？

答：由于PCB为定制化产品，公司主要采用“以销定产”的生产模式，以及与之相匹配的“以产定购”与“保持安全库存量”相结合的采购模式，同时每周监控物料和成品的库龄，尽量减少呆滞、临期、过期库存。公司2024年库存周转率为7.59次，与同行业其他上市公司相比，表现良好。

11、请问泰国投资的目的，什么时候开始投产？

答：公司在泰国投资建设生产基地，是公司实施海外战略布局的重要举措，有利于完善公司海外生产基地的布局，建立海外产品服务供应能力，更好地为海外客户提供服务，提升公司的国际竞争力和整体的抗风险能力，符合公司整体的战略规划。目前公司正在积极推进泰国工厂的基建筹备工作，预计2027年能正式投产。具体以实际建设投产时间为准，敬请关注公司后续披露的进展公告。

12、请问公司在成本管控方面有什么优势？

答：公司主要通过以下四个方面降低生产成本：1、控制

	<p>采购成本。2、优化生产工艺，坚持节能降耗，全面提高生产效率。3、提升产品良率。全方位保证产品出货质量，降低内部失败成本。通过专业的检测和技术分析，协助解决客户端品质异常，努力将公司的外部失败成本和客户的损失都降至最低。4、智能化工厂促进数据驱动经营与生产管理能力提升。</p> <p>13、请问公司年报提到三期工厂更加智能化，如何体现？</p> <p>答：募投项目是公司倾力打造的一个“数据集成、自动互联、高效严谨、节能降本”的智能化工厂；其将利用 MES 平台集成大数据库管理，以及通过实施设备自动化集成 EAP 平台、品质管理系统 QMS、智能排程系统 APS、仓库管理系统 WMS、自动 AGV 物流流转等，打造自动化、数字化、智能化的生产线，并促进数据驱动经营与管理能力的提升。公司高度重视企业数字化建设，未来公司将持续加大投入，进一步增强科技创新牵引力，提升公司核心竞争力。</p> <p>14、请问公司接下来会更注重整体营收的提升还是利润指标的提升？</p> <p>答：公司募投项目将于 2025 年 12 月达到预定可使用状态，随着募投项目的逐步爬坡，整体产能也将会有较大的提升。公司将坚持发扬“以客户为聚点，以质量为生命，以革新为动力，追求卓越，实现股东权益、员工利益和社会责任”的经营宗旨，秉承“奋斗、革新、坚守、朴实”的价值观，立足于高精密电路板产业广阔的市场空间和历史机遇，以高增长、高效率、智能化为发展基调，加强与全球一流企业（客户和供应商）的深度合作，致力于实现“成为全球电子电路行业具有影响力的标杆企业”的愿景，追求一定利润水平上的成长的最大化，谢谢。</p> <p>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025 年 6 月 6 日</p>